

杭州士兰微电子股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会  
会议资料



## 会议资料目录

- |  |        |
|--|--------|
| 1、议案之一：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                      | 第 3 页  |
| 2、议案之二：关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案                | 第 3 页  |
| 3、议案之三：关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案                    | 第 6 页  |
| 4、议案之四：关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案         | 第 6 页  |
| 5、议案之五：关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案              | 第 7 页  |
| 6、议案之六：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案 | 第 9 页  |
| 7、议案之七：关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案；   | 第 11 页 |
| 8、议案之八：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                         | 第 22 页 |

## 议案之一：

### 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

根据公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票的安排，公司对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经过自查和论证，确认公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

## 议案之二：

### 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

根据公司拟非公开发行 A 股股票的安排，制订本次发行上市的具体方案如下：

##### 2.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

##### 2.2 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。

### 2.3 发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过 130,505,709 股（含 130,505,709 股）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

### 2.4 发行价格和定价原则

本次非公开发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议公告之日，即 2016 年 12 月 14 日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即不低于 6.13 元/股）。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据特定发行对象竞价申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行底价将进行相应调整。

### 2.5 发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。

所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

### 2.6 上市地点

在禁售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

### 2.7 本次发行股票的限售期

本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

### 2.8 本次发行前滚存利润的安排

本次发行前的滚存利润，由本次发行完成后的全体股东依照持股比例共同享有。

### 2.9 本次发行决议的有效期

本次发行决议自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。

### 2.10 本次发行募集资金用途

本次募集资金总额不超过人民币 80,000 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253	80,000
1.1	其中：MEMS 传感器芯片制造扩产项目	37,900	37,647
1.2	MEMS 传感器封装项目	22,362	22,362
1.3	MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991	19,991
<b>合计</b>		<b>80,253</b>	<b>不超过 80,000</b>

注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准。

其中，MEMS 传感器芯片制造扩产项目由杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）负责具体实施，募集资金将通过公司向士兰集成增资的方式投入；MEMS 传感器封装项目由成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）负责具体实施，募集资金将通过公司向成都士兰增资的方式投入；MEMS 传感器测试能力提升项目由本公司负责实施。

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司将通过自筹资金解决。

公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额、投资进度安排及具体方式等事项进行适当调整。

关联股东陈向东先生和罗华兵先生对此项子议案进行回避。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

### 议案之三：

#### 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案

《杭州士兰微电子股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

关联股东陈向东先生和罗华兵先生对此项议案进行回避。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

### 议案之四：

#### 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

《杭州士兰微电子股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

关联股东陈向东先生和罗华兵先生对此项议案进行回避。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

## 议案之五：

### 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案

##### （一）关联交易概述

本次发行募集资金投资项目中“MEMS 传感器芯片制造扩产项目”拟通过公司控股子公司士兰集成具体实施，募集资金将通过公司向士兰集成增资的方式投入。由于公司关联方友旺电子持有士兰集成 1.5% 股权，因此公司向士兰集成的增资行为构成关联交易。

公司、杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、杭州士兰明芯科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“士兰明芯”）分别持有士兰集成 97%、1.5%、1.5% 股权。公司持有友旺电子 40% 股权，且公司董事长陈向东担任友旺电子副董事长，公司董事罗华兵担任友旺电子董事、总经理，故该事项构成关联交易。

至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与友旺电子之间未发生除日常关联交易以外的其他类别的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## (二) 交易标的基本情况

名称	杭州士兰集成电路有限公司
统一社会信用代码	913301017265863549
注册资本	50,000 万元
公司地址	杭州经济技术开发区 10 号大街（东）308 号
法定代表人	陈向东
成立日期	2001-01-12
经营范围	许可经营项目：制造：集成电路、半导体、分立器件（在许可证的有效期限内经营）。一般经营项目：销售：集成电路、半导体、分立器件；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
股权结构	公司 97%、友旺电子 1.5%、士兰明芯 1.5%

士兰集成最近一年及一期的简要财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2016-09-30	2015-12-31
资产总额	160,723	126,501
所有者权益	63,367	64,395
项目	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	75,110	91,768
营业利润	3,073	3,003
净利润	3,972	5,731

## (三) 关联方基本情况

名称	杭州友旺电子有限公司
统一社会信用代码	9133010060916630XC
注册资本	300 万美元

公司地址	浙江省杭州市滨江区环兴路 1 号
法定代表人	高耿辉
经营范围	半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务
股权结构	台湾友顺科技股份有限公司 60%、士兰微 40%

#### （四）关联交易定价及原则

本次募集资金到位后，公司将与友旺电子、士兰明芯按照定价公允、合理的原则协商确定本次向士兰集成进行增资的价格，待签署相关协议后提交公司董事会和股东大会按照关联交易的决策程序进行审议。

#### （五）关联交易目的及对公司影响

本次非公开发行股票募集资金用途紧紧围绕公司发展战略，投资于公司主业，是公司做大做强 MEMS 传感器项目的重要举措。在募投项目顺利投产后将进一步提高公司集成电路业务特别是 MEMS 传感器业务销售收入，提升公司对 MEMS 传感器的研发设计、制造、封装和测试能力，提高和巩固公司行业地位，增强公司盈利能力。

本次交易完成后，公司不会新增同业竞争，在合并报表层面也不会产生新的关联交易。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

关联股东陈向东先生和罗华兵先生对此项议案进行回避。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

#### 议案之六：

杭州士兰微电子股份有限公司

关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：

（一）授权公司董事会根据审议通过的本次发行方案、中国证监会的核准批文、市场情况及发行人的实际情况，全权负责制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定本次发行的具体的发行时机、发行对象、发行价格、发行方式、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法、认购比例等具体事宜；

（二）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、上市协议、募集资金投资项目实施过程中的投资协议、合作协议等；

（三）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项，包括但不限于制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行股票相关的所有文件，按照监管要求处理与本次非公开发行相关的信息披露事宜；并根据中国证监会审核部门的初审反馈意见及发行审核委员会的审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；

（四）授权董事会根据中国证监会的审核要求，或日后颁布或修订的国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件的要求，或相关市场条件变化情况，或募集资金投资项目实施条件变化情况等，对本次发行的方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行的新股事宜（但国家法律、行政法规、中国证监会行政法规或规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（五）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在法律法规允许的范围内，在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；

（六）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并决定向其支付报酬等相关事宜；

（七）授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜；

（八）授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股

份限售期锁定及限售期届满后新股在上海证券交易所上市的相关事宜；

（九）如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行股票方案作相应调整；

（十）在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，可酌情决定延期或终止实施本次发行计划；

（十一）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

## 议案之七：

### 杭州士兰微电子股份有限公司

#### 关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及 相关填补措施的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

#### 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

##### （一）主要假设及说明

1、假设本次发行于 2017 年 8 月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；

2、假设本次非公开最终募集资金净额为 80,000.00 万元；

3、假设本次非公开发行股票数量为 130,505,709 股，据此测算，发行完成后公司总股本为 1,377,673,709 股，本次非公开发行的股票数量仅为估计值；

4、根据 2016 年前三季度财务数据（未审计），公司 2016 年 1-9 月扣非前后归属于母公司股东的净利润分别为 60,637,660.15 元和 18,383,464.85 元。假设公司 2016 年第四季度归属于母公司股东的净利润与前三季度平均值持平，即 2016 年全年扣非前后净利润分别为 80,850,213.53 元和 24,511,286.47 元，假设 2017 年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润均较 2016 年分别增长 0%（假设一）、5%（假设二）和 10%（假设三）；

5、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

7、在测算 2016 年和 2017 年净资产收益率时，假设 2016 年和 2017 年的盈利是均匀发生的。

8、在测算 2017 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；

9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2016 年、2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。

**（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析**

单位：元

项目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日 (假设一)	2017 年度/2017 年 12 月 31 日 (假设二)	2017 年度/2017 年 12 月 31 日 (假设三)
归属于母公司股	80,850,213.53	80,850,213.53	84,892,724.21	88,935,234.89

东净利润				
归属于母公司股东净利润（扣非后）	24,511,286.47	24,511,286.47	25,736,850.79	26,962,415.11
期末在外普通股股数（股）	1,247,168,000	1,377,673,709	1,377,673,709	1,377,673,709
基本每股收益（扣非后）	0.020	0.019	0.020	0.021
稀释每股收益（扣非后）	0.020	0.019	0.020	0.021
加权平均净资产收益率（扣非后）	1.00%	0.88%	0.92%	0.97%

## 二、关于本次发行摊薄即期回报的情况的风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将大幅增加，虽然本次募投项目的实施将有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力，但由于募集资金投资项目建设和实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

## 三、本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

### （一）本次非公开发行的必要性和合理性

#### 1、项目的建设符合国家产业政策导向

集成电路行业作为现代电子信息产业发展的核心行业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。加快推进集成电路产业发展，对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。

2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，并指出，“主要任务和发展重点为，着力发展集成电路设计业；加速发展集成电路制造业；提升先进封装测试业发展水平；突破集成电路关键装备和材料”。该纲要还特别提出，要大力发展微机电系统（MEMS）等特色专用工艺生产线，增强芯片制

造综合能力，以工艺能力提升带动设计水平提升，以生产线建设带动关键设备和材料配套发展。

2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》明确指出，“着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力。”

公司本次募集资金投资的“年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目”，涵盖了系统集成的设计、制造、封装测试各环节，具有自主知识产权，符合国家产业政策导向。

## 2、本项目的建设受益于 MEMS 应用市场的良好前景

MEMS 下游市场主要为消费电子、汽车电子以及物联网领域等。根据 Yoledeveloppement 的统计数据，2015 年，消费电子、汽车分别贡献了 MEMS 市场 48.4%、31.5% 的份额，其他应用共占 20.1%。

### （1）消费电子 MEMS 市场增速迅猛

受益于智能手机和 VR 需求的快速增长，消费电子 MEMS 市场在未来数年内仍将保持高速增长。

智能手机作为 MEMS 元件最大的应用市场，近年来发展势头强劲。苹果和三星电子仍然是智能手机行业的龙头，然而近年包括华为，OPPO，VIVO，小米，联想和中兴在内的中国的智能手机厂商正在不断崛起，中国已占据全球半数市场份额，同时带动对 MEMS 元器件的强劲需求。

市场调研机构 IDC 发布的报告显示，2015 年中国智能手机出货量达 4.341 亿部，同比增长 2.5%。从厂商在中国市场的表现上看，2015 年出货量前五大的厂商分别为小米、华为、苹果、OPPO 和 VIVO，其中，国有品牌小米、华为、OPPO 和 VIVO 出货量分别为 6,490 万部、6,290 万部、3,530 万部和 3,510 万部，同比增速分别为 23.1%、53.0%、36.3% 和 25.8%。据 IHS 统计，至 2018 年，仅

国内手机的 MEMS 器件市场需求将达到 47 亿件，其中主要需求为运动传感器、麦克风、光传感器等。

国内手机市场的持续发展、国产品牌的迅猛增长以及手机 MEMS 元件国产化率的逐步提升，为 MEMS 的积极发展提供了良好的基础。

## (2) 汽车及物联网市场为 MEMS 传感器提供广阔的发展空间

当前，一辆国内普通家用汽车上安装了大约 100 个传感器，而豪华轿车上的传感器超过 200 个。由于车内布置空间有限，小型化集成化的 MEMS 传感器得到了越来越多的应用。汽车 MEMS 传感器主要有压力传感器、加速度计以及陀螺仪等。

在智能化时代，MEMS 传感器将成为重要的数据入口。物联网 MEMS 传感器按测量对象可以划分为声学传感器、惯性传感器、磁学传感器、电学传感器、生物及化学传感器等。其中人工智能和虚拟现实带来的语音交互需求，为 MEMS 麦克风迎来新的发展机遇。以亚马逊运用于其 Echo 智能家居中的 MEMS 硅麦克风传感器为例，其采用了 6+1MEMS 麦克风阵列技术实现声源定位和定向采集。未来语音交互逐渐渗透进入日常生活，MEMS 麦克风将迎来出货量的大幅增长。

综上，MEMS 传感器市场现在乃至将来都将是一个潜力巨大的市场。

### 3、中高端 MEMS 器件进口依赖度较高，本土化进程将给本土优秀 MEMS 企业带来机遇

根据 EE Times 统计，2015 年国内 IC 和 MEMS 市场总需求为 1,770 亿美元，但是本土制造仅为 9%，约 90% 产品需要进口；到 2020 年，本土化比例预计将提升至 15%，但由于需求总量的提升，仍将有约 2,000 亿美元的缺口。2015 年，我国智能手机出货量达 4.341 亿部，而 MEMS 元器件的国产化水平上停留在 20% 左右。巨大的市场空间以及本土化需求为国内 MEMS 产业创造条件。根据中国半导体行业协会 MEMS 分会会员大会在 2015 年上半年对中国 MEMS 企业的统计，截至 2014 年，中国 MEMS 企业已经有 190 家，但是产品种类单一，性能竞争力不强，代工企业大多处于发展阶段。拥有自行芯片设计、制造及封

测能力，并掌握芯片设计与生产工艺的 IDM 半导体公司较少。通过此次 MEMS 扩产项目的实施，士兰微电子将在 MEMS 本土化进程中提供一体化解决方案，市场前景可期。

4、本项目的建设有利于充分整合公司现有业务资源，符合公司发展规划

公司作为国内为数不多的以 IDM 模式为主要发展模式的综合性半导体产品公司，近年来一直在持之以恒地学习国外综合型集成电路企业的运行经验并付诸实施。

公司拥有经验丰富的集成电路设计人员，对 MEMS 传感器所需要的小信号处理、高精度 ADC 和低功耗设计有较多的项目经验；公司通过设计技术的长期研究和工艺上的不断摸索，并结合国内科研机构的现有成果，形成了一个特有的设计和工艺相结合的团队；公司已在加速度计、地磁传感器、压力传感器等的设计和验证上积累了一定的基础，并推出了三轴加速度计、三轴地磁传感器、六轴惯性单元等产品。

从 2009 年开始，公司陆续投入资金购入了部分 MEMS 专用研发和生产设备，目前公司已实现三轴加速度计的批量生产；公司拥有 6 英寸芯片生产线和在建设中的 8 英寸芯片生产线，能够为传感器的设计和工艺提供短时间内的多次工艺验证，可以对仿真结果进行多次修正，具备较强的工艺研发能力；为了配合传感器的特别测试，公司组建了一支围绕传感器测试技术开发的团队，解决不同传感器的测试需求。

本项目的建设对公司在 MEMS 市场竞争中占领先机具有重要意义。

**（二）募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

**1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

公司从集成电路芯片设计业务开始，逐步搭建了芯片制造平台，并已将技术和制造平台延伸至功率器件、功率模块和 MEMS 传感器的封装领域，建立了较为成熟的 IDM（设计与制造一体）经营模式。近年来，公司从集成电路芯片设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变，在半导体大框架下，形

成了集成电路、功率半导体芯片、MEMS 传感器、LED 等业务的协同发展。

目前，公司基于硅 MEMS 工艺的三轴加速度计已经批量生产，三轴地磁传感器、六轴惯性单元等已开发成功。为顺应和把握发展趋势，抢占 MEMS 传感器发展先机，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟在现有基础上扩产 MEMS 传感器产品 8.9 亿只/年，本次募集资金投资项目属于对公司现有业务的扩产和提升。

## 2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

### (1) 专业的技术研发团队作技术支持

公司非常重视人才引进、培养和研发团队建设，已拥有一批掌握 MEMS 路工艺技术研究开发的骨干人才，培养了一支业务能力强、有相当进取心和工作经验、学历结构合理的年轻的技术和管理干部队伍。

公司技术中心经过多年的发展，积累了丰富的管理经验，形成了成熟的管理制度体系，保障技术中心研发管理良好运作，同时通过制度体系的激励机制，充分调动研发人员的研发积极性。

### (2) 士兰微有完善的研发条件

在研发管理方面，公司建立了项目立项、技术评审、研发计划、技术或产品方案、项目追踪、稽核和总结等各种规范流程，便于项目有效开展和实施。此外，公司配备了完善的设施设备、建立了研发投入核算体系和全面的绩效考核奖励制度。

公司除了有完善的组织架构和制度体系建设外，已经具备研究开发所需要的硬件试验条件。公司目前拥有多个实验室，其中最大的试验室面积 300 平方米，配置有公司大型的、综合性的测试仪器，如冷场发射扫描电子显微镜、聚焦离子束 FIB、SPV 测试仪等，满足产品研发和工艺研发测试的基本需要。

### (3) 士兰微有坚实的扩产基础

公司的 MEMS 传感器研发得到了国家科技重大专项的支持，并已掌握 MEMS 传感器和集成电路的相关技术，目前已申请 MEMS 相关技术专利 100

余项，其中 60 余项已获得授权。

公司已具备成熟的 MEMS 传感器和集成电路生产条件。士兰集成在杭州下沙有成熟的 6 英寸芯片生产线和在建设中的 8 英寸芯片生产线，有一支对芯片生产有丰富经验的生产队伍，为大规模量产打下了坚实基础；公司在成都士兰有专门从事封装的厂房及生产人员，在杭州滨江也有专业的测试厂房及工作人员。

#### （4）公司在市场方面的储备

公司在多年的研发、生产、运营过程中，依托良好的产品质量，积累了较为丰富的客户资源，赢得了较好的市场口碑，形成了较强的客户可持续开发能力。公司经过多年积累，形成了较为完善的产品销售体系，市场销售能力较强。

### 四、公司对保证此次募集资金有效运用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

#### （一）公司现有业务运营状况和发展态势、面临的主要风险及改进措施

##### 1、公司现有业务运营状况和发展态势

近年来，公司从集成电路芯片设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变，在半导体大框架下，形成了集成电路、功率半导体芯片、MEMS 传感器、LED 等业务的协同发展。

公司经过十多年的发展，坚持走“设计制造一体化”道路，在多个产品技术领域构建了核心竞争优势，尤其以 IDM 模式开发高压高功率的特殊集成电路、半导体功率器件与模块、MEMS 传感器等为特色。近几年，公司通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，为公司今后可持续发展增添了动力。

随着半导体信息技术在节能环保、移动互联网、物联网、可穿戴设备、智能制造等领域的广泛应用，半导体行业将面临更为广阔的市场空间。

##### 2、公司面临的主要风险及改进措施

#### （1）宏观风险及其对策

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大,前些年发生的全球性金融危机、欧债危机等都对半导体行业产生了较大影响。目前全球经济增长出现了明显的分化。一方面,美国经济形势总体向好,美联储已停止实施量化宽松政策并已进行首次加息。另一方面,欧元区国家、日本等发达经济体的经济增长未有明显改善、甚至更为疲弱,欧洲央行和日本央行均加大了量化宽松政策的力度,实施了“负利率”政策;同时,经济发达国家实施的超宽松货币政策所带来的货币溢出效应也对新兴国家形成了明显冲击,由于自身及外部因素,金砖国家为代表的新兴经济体的经济增速已明显放缓。对于宏观风险,公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产营运的效率;将进一步拓宽融资渠道、把握好资本运用的节奏,降低债务杠杆。

### (2) 行业周期风险及其对策

半导体行业存在明显的行业周期。近年来,随着技术发展和应用领域更新加速,行业周期呈现缩短趋势。对于行业周期风险,公司将抓住国家大力支持国内集成电路产业发展的有利时机,坚持并完善 IDM 发展模式,通过加大对产品、技术研发的投入、加强市场推广和品牌建设,把握好固定资产投资节奏,从而实现可持续发展。

### (3) 新产品开发风险及其对策

随着半导体消费终端产品市场更新频率的加快,公司产品创新的风险也在加大。如果公司的创新不能踏准市场需求的节奏,公司将浪费较大的资源,并丧失市场机会,不能为公司的发展提供新的动力。针对该类风险,公司将充分结合 IDM 模式的优点,加大对高端功率半导体芯片、MEMS 器件和传感器等新产品的研发投入,加快推出契合市场的新产品,深挖细分市场空间。

## (二) 公司为防范即期回报被摊薄拟采取的具体措施

为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响。

### 1、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次募集配套资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## 2、加速推进募投项目实施进程、提高资金使用效率

在按照相关法律法规的规定使用募集资金的同时，公司将尽可能提高募集资金使用效率，通过实施募投项目逐步完善战略布局，紧跟行业的发展趋势，辅以产业链资源整合。本次募集资金投资项目建成投产后公司将有效提升产能、优化业务结构，促进公司核心竞争力和可持续发展能力的提升。

## 3、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制

公司将严格遵循相关法律法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，为公司未来的健康发展提供制度保障。

## 4、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

公司按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司第五届董事会第二十一次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《杭州士兰微电子股份有限公司股东分红三年（2015-2017）回报规划》，对公司利润分配相关事项、未来分红回报规划做了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。本次发行完成后，公司将严格执行公司章程和现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

## 五、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

## 六、控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行如摊薄即期回报时的相关承诺

公司的控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

议案之八：

杭州士兰微电子股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

《杭州士兰微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已获第六届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日